

설비 Track 개요

1. 명 칭 : 삼성 반도체/Display 설비 Track

2. 지원 사항 : 장학금(등록금 실비)

3. 지원 기준 : Track 내 6개 지정과목 이수, 학점 3.5점(4.5점 만점 기준) 이상

4. 이수 기준 : Track 11개 과목 이수, 학점 3.5점(4.5점 만점 기준) 이상

* Track 과목 : 열역학, 유체역학, 전기전자공학, 응용열역학, 열전달, 유체설계, 수치해석, 기계요소설계,

시스템제어, 반도체공정, 로봇공학 (상세 교과명은 학과에 문의)

설비 Track 선발 절차

